

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-074

沪士电子股份有限公司

关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 项目名称：人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目（下称“本项目”）。
- 投资总额：约 43 亿元人民币。
- 资金来源：公司自有或自筹资金。
- 建设周期：本项目将分两阶段实施，本项目总建设期计划为 8 年。
- 特别风险提示：
 - 本项目总投资额高，且建设资金来源于公司自有或自筹，因此本项目的资金保障可能会受到公司现有厂区经营情况的影响。
 - 本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
 - 本项目建设期长，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。
- 其他：本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；本项目不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。

一、概述

公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，决议在昆山青淞厂投资新建应用于半导体芯片测试

及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目，项目总投资预计约为 19.8 亿元人民币。2022 年 3 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次会议，根据市场和实际经营情况，决议暂缓实施上述项目建设。

现根据印制电路板市场发展趋势及公司实际经营情况，经公司董事会战略委员会提议，公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》，同意将上述项目调整为本项目，生产高层高密度互连积层板，以满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，本项目将分两阶段实施，投资总额预计约为 43 亿元人民币；同意提请股东大会授权董事会根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，对本项目的投资总额（在 30% 的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会的具体召开时间由公司董事会另行确定。

二、项目基本情况

（1）项目名称：

人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目。

（2）建设地点：

位于江苏省苏州市昆山市玉山镇东龙路的公司预留用地。

（3）投资总额：

本项目投资总额约 43 亿元人民币，包括基础建设投入、设备投入、流动资金等。其中第一阶段投资总额约 26.8 亿元人民币；第二阶段投资总额约 16.2 亿元人民币。

（4）资金来源：

公司自有或自筹资金。

（5）建设周期：

本项目将分两阶段实施，本项目总建设期计划为 8 年。其中第一阶段预计在

2028 年以前实施完成；第二阶段预计在 2032 年底前实施完成。

(6) 产品方案和生产规模：

本项目计划年产约 29 万平方米人工智能芯片配套高端印制电路板。其中第一阶段计划年产约 18 万平方米高层高密度互连积层板；第二阶段计划年产约 11 万平方米高层高密度互连积层板。

(7) 项目可行性分析：

本项目全部实施完成后，预估新增年营业收入约为 48 亿元人民币。其中第一阶段实施完成后，预估新增年营业收入约为 30 亿元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为 5.58 亿元人民币；考虑所得税，税率以 15% 计算，净利润约为 4.7 亿元人民币；第二阶段实施完成后，预估新增年营业收入约为 18 亿元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为 3.35 亿元人民币；考虑所得税，税率以 15% 计算，净利润约为 2.85 亿元人民币。

本项目财务评价计算期 14 年（含建设期），折现率按 10%，经测算本项目第一阶段财务内部收益率所得税后约为 21%，高于基准收益率；所得税后投资回收期约为 7 年（含建设期）；经测算本项目第二阶段财务内部收益率所得税后约为 19%，高于基准收益率，所得税后投资回收期约为 8 年（含建设期）。从以上分析看，本项目所得税后财务净现值大于 0，投资回收期，内部收益率适中，从项目投资价值分析角度考虑，项目可行。

本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

三、本项目对公司的影响

本项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，具有良好的市场发展前景。本项目的实施将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本项目不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响。

四、本项目的风险分析及应对

1、本项目投资总额高，且建设资金来源于公司自有或自筹，因此本项目的资金保障可能会受到公司现有厂区经营情况的影响。公司近年来经营情况良好，现金流稳定，现金储备较为充裕，负债率在同业中相对较低，公司将统筹资金安排，以确保项目顺利实施。

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。

3、本项目建设期长，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。如获股东大会批准，公司董事会将根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，对本项目的投资总额（在30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。

4、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。
- 2、公司第七届董事会战略委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日